PROPÓSITO:

Que el estudiante se familiarice con el proceso de extracción de componentes con tecnología SMD y THD, como elemento esencial en su desempeño en el campo de trabajo del Técnico en Electrónica.

MOTIVACIÓN:

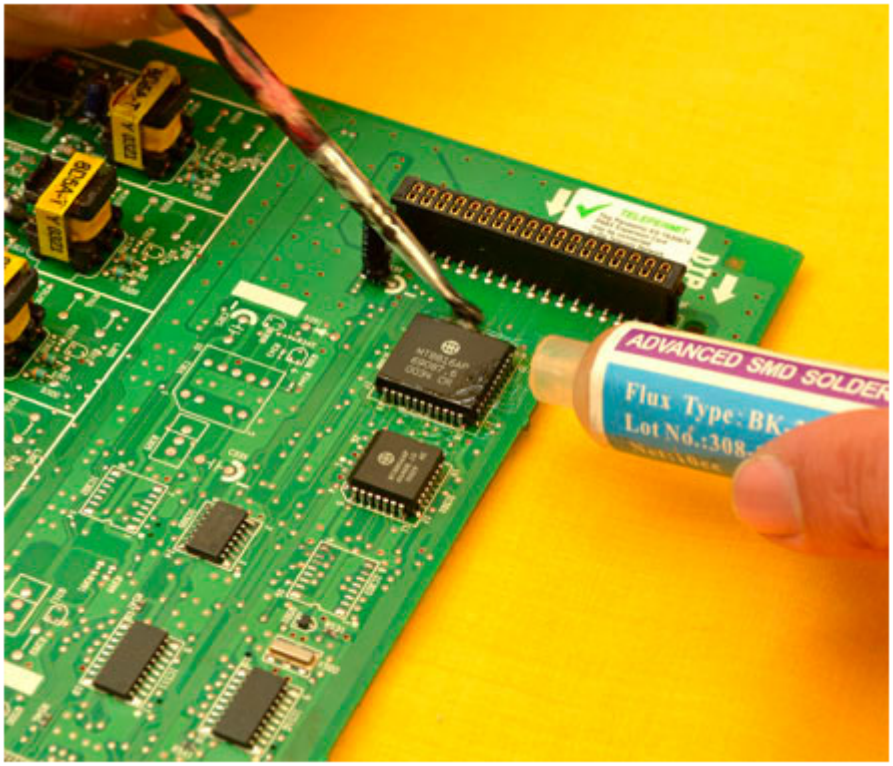


Proceso de Soldadura de Ola Selectiva

EXPLICACIÓN:

Los Circuitos Integrados SMD

En la actualidad los circuitos electrónicos tienen gran cantidad de componentes de montaje superficial. (**SMD = Superficial Mounted Devices**).
Esta tecnología relativamente nueva está remplazando la tecnología anterior, llamada **through hole**, que son los componentes tradicionales que atraviesan el circuito impreso de arriba hacia abajo, soldándolos en su parte inferior.
Son muchas ventajas las que rodean este tipo de componentes. Su producción en masa, su reducido tamaño, bajo consumo de energía, y baja temperatura, los han puesto a la vanguardia de la tecnología, recibiendo el nombre de **Nanotecnología**.
Por ser componentes más pequeños, su montaje o reemplazo requiere cierto cuidado especial. Cuando se fabrican aparatos a gran escala con estos componentes, se usan sistemas de automatización. Su diseño también requiere de técnicas más avanzadas.



EJERCICIOS:

1. Ingresar a: https://capacitateparaelempleo.org

2. Seleccionar el curso: Diseñador de Circuitos Impresos

2. Dirigirse al nivel 2, lección 4.

3. Observar el video No. 3: Extracción de Componentes THD y SMD

4. Realizar un informe en el cuaderno, acompañado de dibujos e ilustraciones a todo color.

5. Realizar un proceso de extracción de componentes THD y SMD

EVALUACIÓN:

1. Revisión del Cuaderno

2. Exposición de Trabajos

3. Plenaria

BIBLIOGRAFÍA:

Como Cambiar un Componente Electrónico de Superficie (SMD)

http://www.videorockola.com/tutoriales/cambiar-componente-electronico-smd/